



具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB收发器，UCSP封装，带USB检测

概述

MAX3344E /MAX3345E USB收发器能够实现逻辑电平至USB信号、USB信号至逻辑电平的转换。内置的1.5kΩ USB上拉电阻，支持全速(12Mbps)USB工作模式。MAX3344E/MAX3345E在USB的I/O引脚、D+和D-以及V_{CC}端提供内置 $\pm 15kV$ ESD保护电路。

MAX3344E/MAX3345E可以工作在低至1.65V的逻辑电源下，保证与低电压ASIC的兼容性。空闲模式下，电源电流降至40μA以内，枚举功能允许器件在插入时逻辑断开。MAX3344E/MAX3345E完全兼容于USB1.1规范，并且在USB2.0规范下可以全速运行。

MAX3344E/MAX3345E具有USB检测电路，可以监视USB总线上是否有设备插入，并可通报这一事件。MAX3344E的USB_DET门限在3.6V(最小)与4V(最大)之间；MAX3345E的USB_DET门限在1V(最小)到2.8V(最大)之间。

MAX3344E/MAX3345E提供微型4 x 4 UCSP™封装和16引脚TSSOP封装，工作温度范围：-40°C到+85°C。

应用

- 蜂窝电话
- PC外设
- 信息终端
- 数据摇篮架
- PDA
- MP3播放器
- 数码相机

特性

- ◆ D+、D-端提供 $\pm 15kV$ ESD保护
- ◆ 与USB1.1规范兼容(可全速运行在2.0)。
- ◆ 独立的VP、VM输入/输出
- ◆ V_L低至1.65V，允许与低压ASIC连接
- ◆ 枚举输入一可以通过软件控制与USB连接
- ◆ USB检测功能
3.6V(最小)至4V(最大)—MAX3344E
1V(最小)至2.8V(最大)—MAX3345E
- ◆ 允许单端或差分逻辑输入/输出
- ◆ 内部线性稳压器使其可以直接从USB供电
- ◆ 内置上拉电阻支持全速工作
- ◆ 三态输出
- ◆ 无供电顺序要求
- ◆ 空闲模式下驱动器有效
- ◆ 提供微型晶片级封装

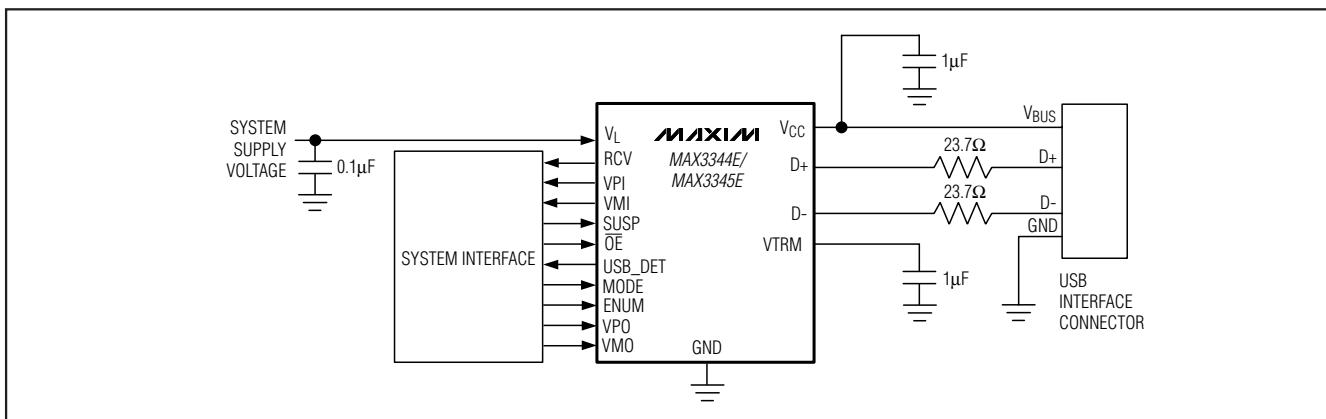
定购信息

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE
MAX3344EEUE	-40°C to +85°C	16 TSSOP
MAX3344EEBE-T	-40°C to +85°C	4 x 4 UCSP
MAX3345EEUE	-40°C to +85°C	16 TSSOP
MAX3345EEBE-T	-40°C to +85°C	4 x 4 UCSP

引脚配置见本资料的最后部分。

UCSP是Maxim Integrated Products, Inc.的一个商标。

典型工作电路



MAX3344E/MAX3345E

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB 收发器, UCSP 封装, 带USB 检测

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(All voltages refer to GND, unless otherwise noted.)	
Supply Voltage (V_{CC})	-0.3V to +6V
Output of Internal Regulator (VTRM)	-0.3V to ($V_{CC} + 0.3V$)
Input Voltage (D+, D-)	-0.3V to +6V
System Supply Voltage (V_L)	-0.3V to +6V
RCV, SUSP, VMO, MODE, VPO, \overline{OE} , VMI, VPI, USB_DET, ENUM	-0.3V to ($V_L + 0.3V$)
Short-Circuit Current (D+, D-) to V_{CC} or GND (Note 1)	Continuous

Maximum Continuous Current (all other pins)	$\pm 15mA$
Continuous Power Dissipation ($T_A = +70^\circ C$)	
16-Pin TSSOP (derate 9.4mW/ $^\circ C$ above $+70^\circ C$)	754mW (U16-2)
4 x 4 UCSP (derate 8.2mW/ $^\circ C$ above $+70^\circ C$)	659mW (B16-1)
Operating Temperature Range	-40°C to +85°C
Junction Temperature	+150°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C
Bump Temperature (soldering) Reflow	+235°C

Note 1: External 23.7Ω resistors connected to D+ and D-.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

($V_{CC} = 4V$ to 5.5V bypassed with 1μF to GND, GND = 0, $V_L = 1.65V$ to 3.6V, ENUM = V_L , $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $V_{CC} = 5V$, $V_L = 2.5V$, $T_A = +25^\circ C$.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
SUPPLY INPUTS (V_{CC}, VTRM, V_L)						
Regulated Supply Voltage Output	V_{VTRM}	Internal regulator	3.0	3.3	3.6	V
V_{CC} Input Range	V_{CC}		4.0	5.5		V
V_L Input Range	V_L		1.65	3.60		V
Operating V_{CC} Supply Current	I_{VCC}	Full-speed transmitting/receiving at 12Mbps, $C_L = 50pF$ on D+ and D-		10		mA
Operating V_L Supply Current	I_{VL}	Full-speed transmitting/receiving at 12Mbps		8		mA
Full-Speed Idle and SE0 Supply Current	$I_{VCC(IDLE)}$	Full-speed idle: $V_{D+} > 2.7V$, $V_{D-} < 0.3V$	340	450		μA
		SE0: $V_{D+} < 0.3V$, $V_{D-} < 0.3V$	390	500		
Static V_L Supply Current	$I_{VL(STATIC)}$	Full-speed idle, SE0, or suspend mode		12.5		μA
Suspend Supply Current	$I_{VCC(SUSP)}$	$SUSP = \overline{OE} = \text{high}$		40		μA
Disable-Mode Supply Current	$I_{VCC(DIS)}$	$V_L = \text{GND}$ or open		20		μA
D+/D- Disable-Mode Load Current	I_{D_DIS}	$V_L = \text{GND}$ or open, $V_{D_} = 0$ or +5.5V		5		μA
Sharing-Mode V_L Supply Current	$I_{VL(SHARING)}$	$V_{CC} = \text{GND}$ or open, $\overline{OE} = \text{low}$, $SUSP = \text{high}$		20		μA
D+/D- Sharing-Mode Load Current	$I_{D_SHARING}$	$V_{CC} = \text{GND}$ or open, $V_{D_} = 0$ or +5.5V		20		μA
LOGIC-SIDE I/O						
Input High Voltage	V_{IH}	SUSP, MODE, ENUM, \overline{OE} , VMO, VPO	2/3 x V_L			V
Input Low Voltage	V_{IL}	SUSP, MODE, ENUM, \overline{OE} , VMO, VPO		0.4		V
Output-Voltage High	V_{OH}	VPI, VMI, RCV, USB_DET; $ I_{SOURCE} = 2mA$	$V_L - 0.4$			V
Output-Voltage Low	V_{OL}	VPI, VMI, RCV, USB_DET; $ I_{SINK} = -2mA$		0.4		V

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB收发器，UCSP封装，带USB检测

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

($V_{CC} = 4V$ to $5.5V$ bypassed with $1\mu F$ to GND, GND = 0, $V_L = 1.65V$ to $3.6V$, ENUM = V_L , TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at $V_{CC} = 5V$, $V_L = 2.5V$, TA = $+25^\circ C$.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Input Leakage Current		SUSP, MODE, ENUM, \overline{OE} , VMO, VPO = 0 or V_L		± 1		μA
USB-SIDE I/O						
Output-Voltage Low	V_{OL}	$R_L = 1.5k\Omega$ from D+ or D- to $3.6V$		0.3		V
Output-Voltage High	V_{OH}	$R_L = 15k\Omega$ from D+ and D- to GND	2.8	3.6		V
Input Impedance	Z_{IN}	Three-state driver, ENUM = 0, $V_{D_} = 0$ or $+3.6V$	1			$M\Omega$
Single-Ended Input-Voltage High	V_{IH}		2.0			V
Single-Ended Input-Voltage Low	V_{IL}			0.8		V
Receiver Single-Ended Hysteresis	V_{HYS}			200		mV
Differential Input Sensitivity	V_{DIFF}		200			mV
Input Common-Mode Voltage Range	V_{CM}		0.8	2.5		V
Driver Output Impedance	R_{OUT}		4.6	16.0		Ω
Internal Pullup Resistor	R_{PU}		1.410	1.500	1.540	$k\Omega$
USB_DET Threshold	$V_{USBBLH1}$	MAX3344E		4.0		V
	V_{USBHL1}	MAX3344E	3.6			
	$V_{USBBLH2}$	MAX3345E		2.8		
	V_{USBHL2}	MAX3345E	1			
USB_DET Hysteresis	V_{USBHYS}	MAX3344E		25		mV
LINEAR REGULATOR						
External Capacitor	C_{OUT}	Compensation of linear regulator	1			μF
ESD PROTECTION (V_{CC}, D+, D-)						
Human Body Model				± 15		kV
IEC1000-4-2 Air-Gap Discharge				± 10		kV
IEC1000-4-2 Contact Discharge				± 8		kV

TIMING CHARACTERISTICS

($V_{CC} = 4V$ to $5.5V$, GND = 0, $V_L = 1.65V$ to $3.6V$, ENUM = V_L , TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Typical values are at $V_{CC} = 5V$, $V_L = 2.5V$, TA = $+25^\circ C$.) (Figures 2–6) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
TRANSMITTER						
\overline{OE} to Transmit Delay Enable Time	t_{PZD}	Figures 2 and 6c		20		ns
\overline{OE} to Driver Three-State Delay Driver Disable Time	t_{PDZ}	Figures 2 and 6c		20		ns
VPO/VMO to D+/D- Propagation Delay	$t_{PLH1(driv)}$	MODE = high, Figures 4 and 6b	10	18		ns
	$t_{PHL1(driv)}$	MODE = high, Figures 4 and 6b	10	18		
VPO/VMO D+/D- Propagation Delay	$t_{PLH0(driv)}$	MODE = low, Figures 3 and 6c	11	20		ns
	$t_{PHL0(driv)}$	MODE = low, Figures 3 and 6c	11	20		

具有 $\pm 15kV$ ESD保护的USB收发器, UCSP封装, 带USB检测

TIMING CHARACTERISTICS (continued)

($V_{CC} = 4V$ to $5.5V$, $GND = 0$, $V_L = 1.65V$ to $3.6V$, $ENUM = V_L$, $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted. Typical values are at $V_{CC} = 5V$, $V_L = 2.5V$, $T_A = +25^\circ C$.) (Figures 2–6) (Note 2)

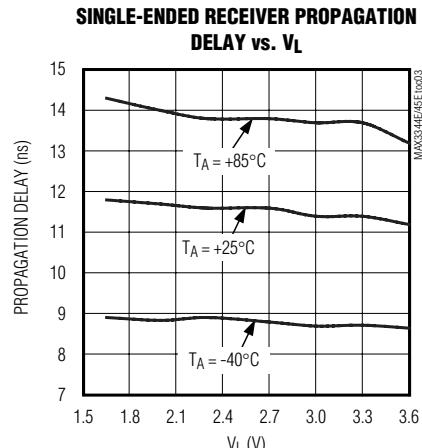
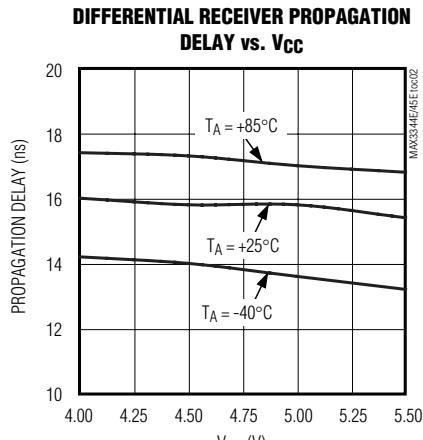
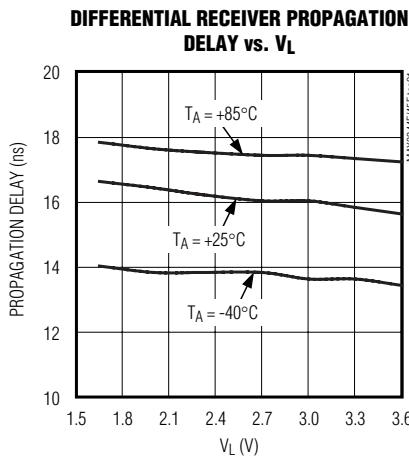
PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Rise Time D+/D-	t_{R1}	$C_L = 50pF$, 10% to 90% of $ V_{OH} - V_{OL} $	4		20	ns
Fall Time D+/D-	t_{F1}	$C_L = 50pF$, 90% to 10% of $ V_{OH} - V_{OL} $	4		20	ns
Rise- and Fall-Time Matching	t_{R1}/t_{F1}	(Note 3)	90		111	%
Output Signal Crossover	V_{CRS}	(Note 3)	1.3		2.0	V
DIFFERENTIAL RECEIVER (Figures 5 and 6a)						
D+/D- to RCV Propagation Delay	$t_{PLH}(RCV)$				18	ns
	$t_{PHL}(RCV)$				18	ns
SINGLE-ENDED RECEIVERS (Figures 5 and 6a)						
D+/D- to VPI or VMI Propagation Delay	$t_{PLH}(SE)$				18	ns
	$t_{PHL}(SE)$				18	ns

Note 2: Parameters are 100% production tested at $25^\circ C$, limits over temperature are guaranteed by design.

Note 3: Guaranteed by design, not production tested.

典型工作特性

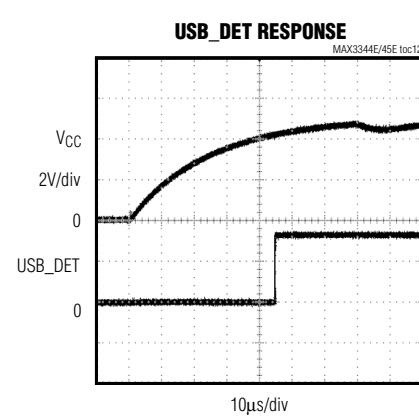
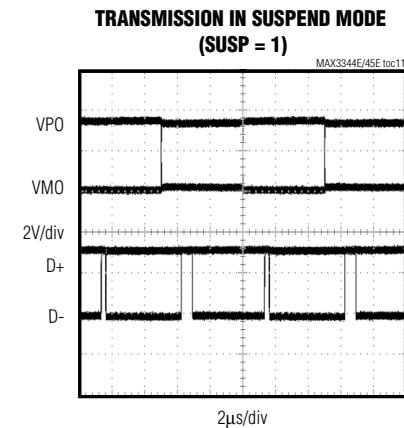
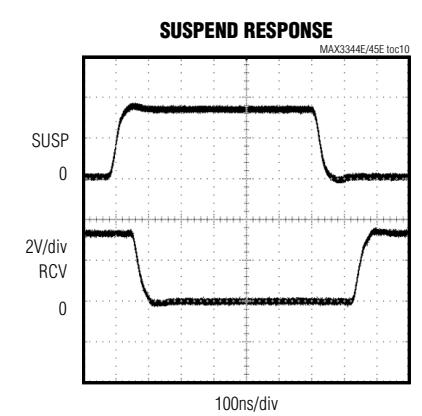
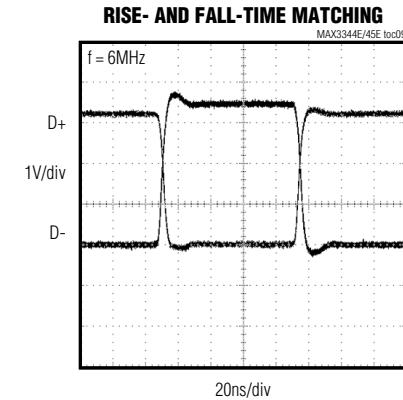
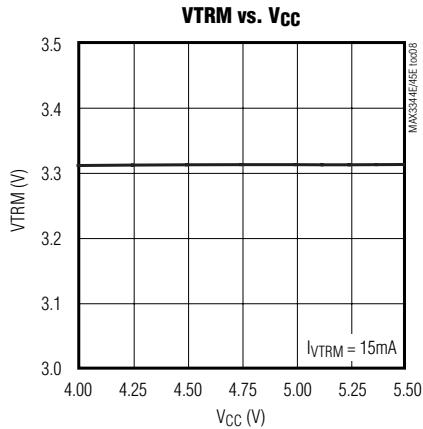
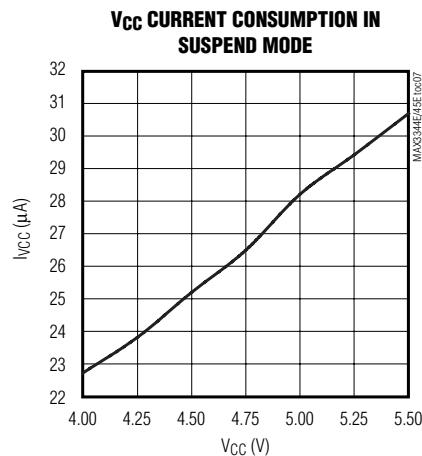
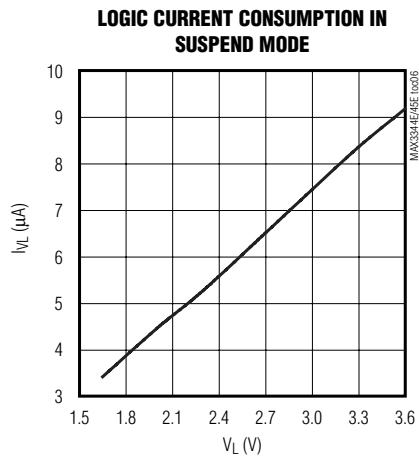
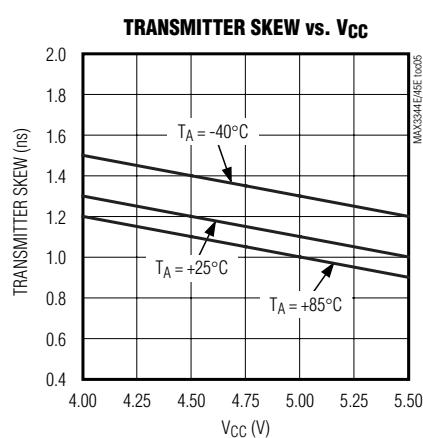
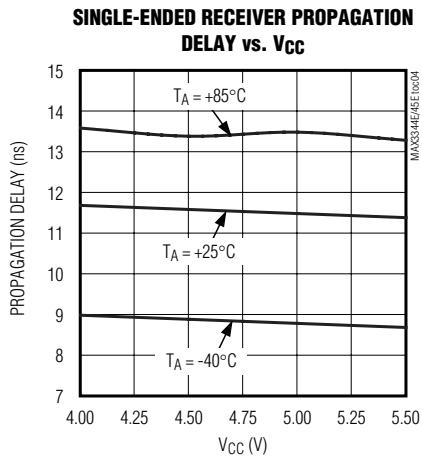
($V_{CC} = 5V$, $V_L = 3.3V$, $T_A = +25^\circ C$, unless otherwise noted.)



具有 $\pm 15kV$ ESD保护的USB收发器，UCSP封装，带USB检测

典型工作特性(续)

($V_{CC} = 5V$, $V_L = 3.3V$, $T_A = +25^{\circ}C$, unless otherwise noted.)



具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB 收发器， UCSP 封装，带USB 检测

引脚说明

引脚		名称	输入/ 输出	功能
TSSOP	UCSP			
1	D2	RCV	Output	接收器输出。单端CMOS 输出，RCV 对应于D+、D-差分输入数据。
2	D1	VPO	Input	逻辑电平数据输入。VPO 电平被转换到D+。
3	C2	MODE	Input	模式控制输入。选择差分(模式1)或单端(模式0)输入，单端输入用于将逻辑电平转换为USB 信号时的系统侧。MODE 置高选择模式1，置低选择模式0。
4	C1	VMO	Input	逻辑电平数据输入，VMO 电平被转换到D-。
5	B1	\overline{OE}	Input	输出使能。 \overline{OE} 置低时，允许数据向D+、D-端传输， \overline{OE} 置高时禁止数据发送或接收数据。
6	B2	SUSP	Input	空闲模式输入。SUSP 置低时，芯片正常工作；SUSP 置高时为低功耗状态。低功耗状态下，RCV 为低、VPI/VMI 有效。
7	A1	VPI	Output	逻辑电平数据输出。VPI 为D+ 端的电平转换值。
8	A2	VMI	Output	逻辑电平数据输出。VMI 为D- 端的电平转换值。
9	B3	ENUM	Input	枚举。ENUM 置高时，内部 $1.5k\Omega$ 电阻连接到D+ 与3.3V 之间，ENUM 置低时断开 $1.5k\Omega$ 电阻。
10	A3	VCC	Power	USB 侧供电输入。VCC 接USB 电源。在VCC 和GND 之间接 $1\mu F$ 旁路电容。
11	A4	GND	Power	地
12	B4	D-	Input/ Output	USB 差分数据输入/输出的负端。通过一个 $23.7\Omega \pm 1\%$ 电阻接USB 的D- 信号。
13	C4	D+	Input/ Output	USB 差分数据输入/输出的正端。通过一个 $23.7\Omega \pm 1\%$ 电阻接USB 的D+ 信号。
14	D4	VTRM	Power	稳压输出。VTRM 从VCC 获得3.3V 输出。VTRM 和地之间接 $1\mu F$ (最小)、低ESR 的旁路电容，如陶瓷或塑封电容。
15	D3	V _L	Power	系统侧电源输入，接系统的逻辑电源，1.65V 至3.6V。
16	C3	USB_DET	Output	USB 检测器输出。USB_DET 为高电平时，指示总线上存在VCC；USB_DET 为低时表明总线上不存在VCC。MAX3344E 的USB_DET 门限在3.6V (最小) 至4V (最大) 之间；MAX3345E 的USB_DET 门限在1V (最小) 至2.8V (最大) 之间。

详细说明

MAX3344E/MAX3345E 为双向收发器，将单端或差分逻辑电平信号转换为差分USB 信号，也可以将差分USB 信号转换为单端或差分逻辑电平信号。MAX3344E/MAX3345E 工作在V_{CC} = 5.5V 至V_{CC} = 3V (V_{CC} < 4V 时不能保证电气规范)。两种器件均带一个 $1.5k\Omega$ 的内部上拉电阻，可以连接在D+ 和VTRM 之间，也可以断开连接(见功能框图)。

MAX3344E /MAX3345E 允许V_{CC} > V_L 或V_L > V_{CC} 的供电顺序。此外，USB I/O，D+ 与D- 和V_{CC} 均具有 $\pm 15kV$

的ESD 保护。MAX3344E/MAX3345E 可以直接从USB 接口获得USB 电源(V_{CC})，能够工作在低至1.65V 的逻辑电源(V_L)，并保证符合USB 的物理层规范。MAX3344E/MAX3345E 支持全速(12Mbps) USB 2.0 规范。

MAX3344E/MAX3345E 具有枚举功能，一旦上电便启动该项功能。ENUM 置低时，断开内置 $1.5k\Omega$ 上拉电阻与D+ 端的连接。这对于供电状态下需要改变通信协议，且USB 线缆处于连接状态的情形非常有用。

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB收发器，UCSP封装，带USB检测

MAX3344E/MAX3345E

电源配置

标准工作模式

将 V_L 和 V_{CC} 接到系统电源(见表1)。 V_L 接+1.65V至+3.6V电源, V_{CC} 接+4.0V至+5.5V电源。另外, MAX3344E/MAX3345E也可以由单节Li+电池供电。电池应与 V_{CC} 连接。当 V_{CC} 低至+3.1V时 V_{VTRM} 仍能维持在+3.0V以上。

此外, MAX3344E/MAX3345E也可以由3.3V $\pm 10\%$ 的稳压源供电。此时, V_{CC} 和 V_{VTRM} 与外部+3.3V电源相连。

禁止模式

V_{CC} 接系统电源、而 V_L 悬空或接地时, 芯片工作在禁止模式。D+和D-进入三态模式, V_{CC} 仅消耗不到20 μA 的电源电流。禁止模式下, D+和D-可承受+5.5V的外部信号(见表2)。

共享模式

V_L 接系统电源、 V_{CC} 悬空或接地时, 芯片处于共享模式。D+和D-进入三态模式, 允许其它电路共享USB的D+、D-总线, V_L 消耗电流小于20 μA 。共享模式下D+和D-可承受+5.5V的外部信号(见表2)。

器件控制

D+和D-

D+和D-是USB侧发送器的I/O连接, 并具有ESD保护功能, 可承受 $\pm 15kV$ 人体模式、 $\pm 10kV$ IEC 1000-4-2气隙放电模式、 $\pm 8kV$ IEC 1000-4-2接触放电模式, 这些性能使得MAX3344E/MAX3345E非常适合要求稳固传输的系统。为确保正常工作, D+和D-端各需一个23.7 Ω 的电阻(参考“外部电阻选择”)。

ENUM

USB2.0规范要求在D+端接一个1.5k Ω 的上拉电阻, 以保证全速(12Mbps)运行。通过枚举(ENUM)控制, MAX3344E/MAX3345E在内部提供1.5k Ω 电阻。ENUM置高, 内部1.5k Ω 上拉电阻接到D+和VTRM之间; ENUM置低, 断开上拉电阻与D+和VTRM之间的连接。

VPO/VMO、VPI/VMi 和 \overline{OE}

MAX3344E/MAX3345E系统侧输入为VPO和VMO。数据由VPO和VMO进入MAX3344E/MAX3345E, VPO、VMO可以工作在差分方式(VPO为正端、VMO为负端)或单端方式(VPO为数据输入)(见“模式选择”)

表1、电源配置

V_{CC}(V)	V_{VTRM}(V)	V_L(V)	CONFIGURATION	NOTES
+4.0 to +5.5	+3.3 Output	+1.65 to +3.6	Normal mode	—
+3.1 to +4.5	+3.3 Output	+1.65 to +3.6	Battery supply	—
+3.0 to +3.6	+3.0 to +3.6 Input	+1.65 to +3.6	Voltage regulator supply	—
GND or floating	Output	+1.65 to +3.6	Sharing mode	Table 2
+3.0 to +5.5	Output	GND or floating	Disable mode	Table 2

表2、禁止模式和共享模式配置

INPUTS/OUTPUTS	DISABLE MODE	SHARING MODE
V_{CC}/V_{VTRM}	<ul style="list-style-type: none"> • +5V input/+3.3V output • +3.3V input/+3.3V input • +3.7V input/+3.3V output 	<ul style="list-style-type: none"> • Floating or connected to GND • < +3.6V (MAX3344E) • < +1.0V (MAX3345E)
V_L	Floating or connected to GND	+1.65V to +3.6V input
D+ and D-	High impedance	High impedance
VPI and VMi	Invalid*	High impedance for $\overline{OE} = \text{Low}$ High for $\overline{OE} = \text{High}$
RCV	Invalid*	Undefined**
SPEED, SUSP, \overline{OE} , ENUM	High impedance	High impedance

*High Impedance or low.

**High or low.

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB 收发器, UCSP 封装, 带USB 检测

MAX3344E/MAX3345E 系统侧输出为 VPI、VMI 和 RCV。MAX3344E/MAX3345E 通过这三个引脚发送数据。VPI 和 VMI 是单端接收器输出, RCV 是差分接收器输出。

输出使能 \overline{OE} 控制数据传输。 \overline{OE} 为低时, 数据能够传送至 D+ 和 D-。 \overline{OE} 为高时, 禁止数据发送或接收。

模式选择

MODE 是控制输入端, 用于选择 MAX3344E/MAX3345E 系统侧的逻辑信号是差分方式还是单端方式。MODE 为高时选择差分方式 (VPO 为正端、VMO 为负端); MODE 为低时选择单端方式 (VPO 为数据输入端) (见表3)。

VTRM

VTRM 是内部线性稳压器的 3.3V 输出。VTRM 为 MAX3344E/MAX3345E USB 侧的内部电路供电。VTRM 和 GND 之间接 1 μ F、低 ESR 陶瓷电容或塑封电容, 且尽可能靠近 VTRM 引脚。不要用 VTRM 为外部电路供电。

V_{CC}

V_{CC} 和 GND 之间接 1 μ F 陶瓷电容旁路, 且尽可能靠近 V_{CC} 。当 V_{CC} 跌落到 USB 检测门限以下时, 电源电流降至 20 μ A 以内, 以避免消耗额外的 V_{CC} 电流, D+/D- 端进入高阻态, 允许其它设备驱动总线。

USB 检测

USB 检测输出 (USB_DET) 用于指示 V_{CC} 是否存在。USB_DET 为高, 表明存在 V_{CC} 电压; USB_DET 为低, 表明不存在 V_{CC} 电压。MAX3344E 的 USB_DET 检测门限在 3.6V (最小) 至 4V (最大), 而 MAX3345E 的 USB_DET 检测门限在 1V (最小) 至 2.8V (最大)。

SUSP

空闲端 (SUSP) 是控制输入。将 SUSP 置高, MAX3344E/MAX3345E 处于低功耗状态, 此时, V_{CC} 的静态电流低于 40 μ A, 同时 RCV 变低。

空闲模式下, VPI 和 VMI 作为接收器输出保持有效, VTRM 也有效。MAX3344E/MAX3345E 可连续地从 USB 接收数据, 允许 μ P 检测 D+/D- 上的有效信号, 唤醒 MAX3344E/MAX3345E。

空闲模式下, MAX3344E/MAX3345E 也可以向 D+/D- 端传送数据。该功能通过在 D+/D- 端驱动一个周期为 1ms 至 15ms 的信号实现远端唤醒。空闲模式下, 数据只能以全速方式的摆率控制传输。

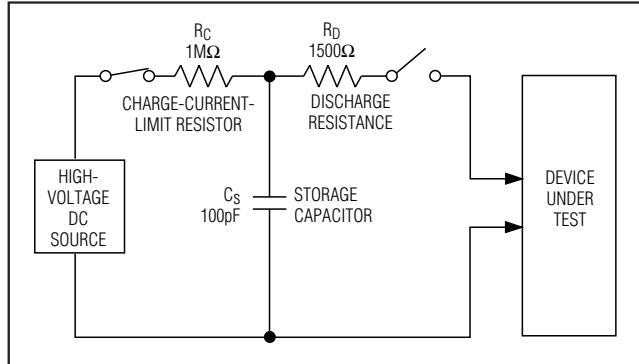


图 1a、人体 ESD 测试模型

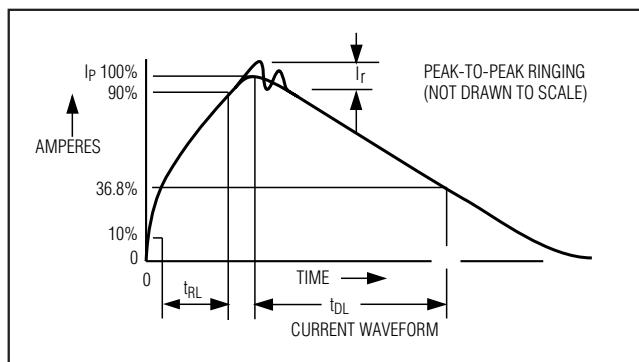


图 1b、人体模型下的电流波形

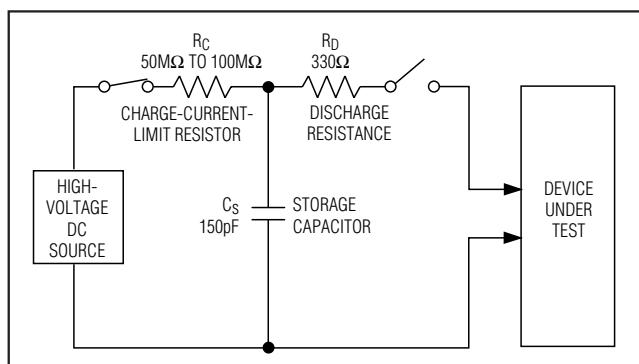


图 1c、IEC 1000-4-2 ESD 测试模型

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB收发器，UCSP封装，带USB检测

MAX3344E/MAX3345E

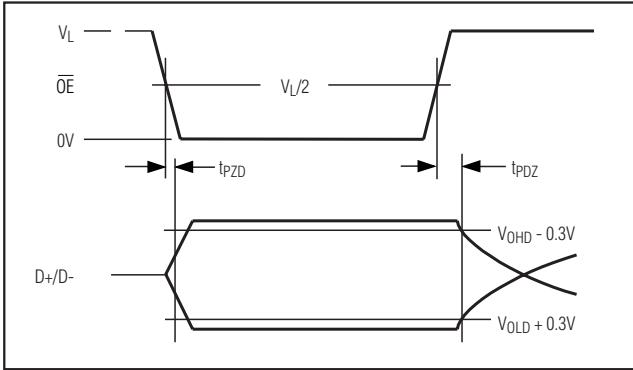


图2、发送使能和禁止时序

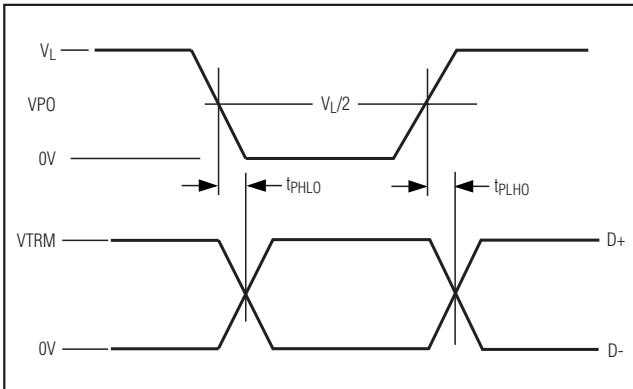


图3、模式0时序

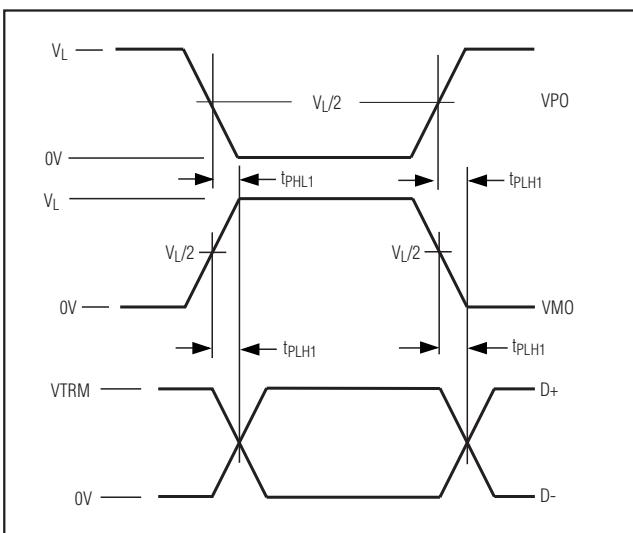


图4、模式I时序

数据传输

从USB接收数据

从USB接收到的数据以差分或单端方式输出到VPI/VMI端。从USB端接收数据时，将 \overline{OE} 置高，SUSP置低。到达D+/D-端的差分数据表现为VPI/VMI的差分逻辑信号，RCV端的单端逻辑信号。若D+和D-均为低，则VPI和VMI也为低，总线上为单端零状态；RCV保持最后一次已知状态(见表3)。

传输数据到USB

MAX3344E/MAX3345E向USB发送的数据以差分形式出现在D+和D-端。逻辑驱动信号可以是差分信号，也可以是单端信号。发送差分逻辑时，将MODE置高、 \overline{OE} 和SUSP置低，数据作用在VPO和VMO端。D+将跟随VPO、D-跟随VMO变化。发送单端逻辑信号时，将MODE、 \overline{OE} 和SUSP置低，数据作用在VPO/VMO端。

ESD保护

为保护MAX3344E/MAX3345E不被ESD损坏，D+和D-端具有增强的抗静电措施，提供 $\pm 15kV$ ESD保护。ESD结构可以在任何状态下承受较高的ESD冲击—标准模式、空闲模式和掉电模式。为使ESD电路正确工作，必须在VTRM和GND之间接 $1\mu F$ 或更大的电容。

ESD保护可以以各种方式测量；D+和D-输入/输出脚具有下面的保护功能：

- 1) $\pm 15kV$ 人体模式
- 2) $\pm 8kV$ IEC 1000-4-2接触放电模式
- 3) $\pm 10kV$ IEC 1000-4-2气隙放电模式

ESD测试条件

ESD性能依赖于诸多因素，如需可靠性报告，请与Maxim公司联系，该报告详细说明了测试装置、测试方法和测试结果。

人体模型

图1a表示人体模型，图1b为低阻放电时产生的电流波形。该模型包括一个充电至感兴趣的ESD电压的 $100pF$ 电容，然后再通过 $1.5k\Omega$ 电阻对测试设备放电。

具有 $\pm 15kV$ ESD保护的USB收发器， UCSP封装，带USB检测

表3a、发送真值表(SUSP = 0、 \overline{OE} = 0、ENUM = X)

INPUT			OUTPUT					
MODE	VPO	VMO	D+	D-	RCV	VPI	VMI	RESULT
0	0	0	0	1	0	0	1	LOGIC 0
0	0	1	0	0	RCV*	0	0	SE0
0	1	0	1	0	1	1	0	LOGIC 1
0	1	1	0	0	RCV*	0	0	SE0
1	0	0	0	0	RCV*	0	0	SE0
1	0	1	0	1	0	0	1	LOGIC 0
1	1	0	1	0	1	1	0	LOGIC 1
1	1	1	1	1	X	1	1	UNDEFINED

*RCV denotes the signal level on output RCV just before SE0 state occurs. This level is stable during the SE0 period.

表3b、接收真值表(SUSP = 0、 \overline{OE} = 1、ENUM = X)

INPUT		OUTPUT			
D+	D-	RCV	VPI	VMI	RESULT
0	0	RCV*	0	0	SE0
0	1	0	0	1	LOGIC 0
1	0	1	1	0	LOGIC 1
1	1	X	1	1	UNDEFINED

*RCV denotes the signal level on output RCV just before SE0 state occurs. This level is stable during the SE0 period.

表3c、空闲模式下发送真值表* (SUSP = 1、 \overline{OE} = 0、ENUM = X)

INPUT			OUTPUT					
MODE	VPO	VMO	D+	D-	RCV	VPI	VMI	RESULT
0	0	0	0	1	0	0	1	LOGIC 0
0	0	1	0	0	0	0	0	SE0
0	1	0	1	0	0	1	0	LOGIC 1
0	1	1	0	0	0	0	0	SE0
1	0	0	0	0	0	0	0	SE0
1	0	1	0	1	0	0	1	LOGIC 0
1	1	0	1	0	0	1	0	LOGIC 1
1	1	1	1	1	0	1	1	UNDEFINED

*Timing specifications are not guaranteed for D+ and D-.

表3d、空闲模式下接收真值表* (SUSP = 1、 \overline{OE} = 1、MODE = X、VPO/VMO = X、
ENUM = X)

INPUT		OUTPUT			
D+	D-	RCV	VPI	VMI	RESULT
0	0	0	0	0	VPI/VMI ACTIVE
0	1	0	0	1	VPI/VMI ACTIVE
1	0	0	1	0	VPI/VMI ACTIVE
1	1	0	1	1	VPI/VMI ACTIVE

*Timing specifications are not guaranteed for D+ and D-.

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB收发器，UCSP封装，带USB检测

IEC 1000-4-2

IEC 1000-4-2 标准包括最终产品的ESD测试和性能评估，它没有特别针对集成电路。MAX3344E/MAX3345E有助于用户设备满足IEC 1000-4-2第4级标准，无需额外的ESD保护元件。

用人体模型和IEC 1000-4-2模型作测试的主要区别在于，IEC 1000-4-2 具有更高的峰值电流，因为在IEC 1000-4-2模型中使用了较低的串联电阻。因此，IEC 1000-4-2模型下能承受的ESD电压通常低于人体模型下的电压。图1c给出了IEC 1000-4-2模型。

气隙放电方式中采用充电探针靠近设备的方法，接触放电模型是在探针放电前将其与设备接触。

机械模型

ESD 测试的机械模型是用200pF储能电容和零放电电阻测试全部引脚，目的是为了仿真制造过程中因接触或装配引起的压力。在制造过程中所有的管脚都必须经过这种保护测试。因此，在印刷电路板装配完成后，机械模型与I/O端口的测试无关。

应用信息

外围元件

外部电阻

需要两个阻值在 $23.7\Omega \pm 1\%$ 至 $27.4\Omega \pm 1\%$ 、 $1/2\text{ W}$ 的电阻与USB连接，两个电阻分别放置在MAX3344E/MAX3345E 和USB连接器的D+和D-线上（见“典型工作电路”）。

外部电容

正常工作时需要三个电容： $0.1\mu\text{F}$ 陶瓷电容用于 V_L 去耦、 $1\mu\text{F}$ 陶瓷电容用于 V_{CC} 去耦、一个 $1.0\mu\text{F}$ （最小）的陶瓷或塑封电容为 V_{TRM} 提供去耦。所有的电容都接GND。

UCSP 应用信息

关于UCSP结构、尺寸、载带信息、印刷电路板技术、焊盘布局、所推荐的回流温度特性、以及可靠性测试结果的最新应用数据，请参考UCSP应用笔记：A Wafer-level Chip-Scale Package，可从Maxim网站：www.maxim-ic.com/UCSP下载。

芯片信息

TRANSISTOR COUNT: 2162

PROCESS: BiCMOS

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB 收发器, UCSP 封装, 带USB 检测

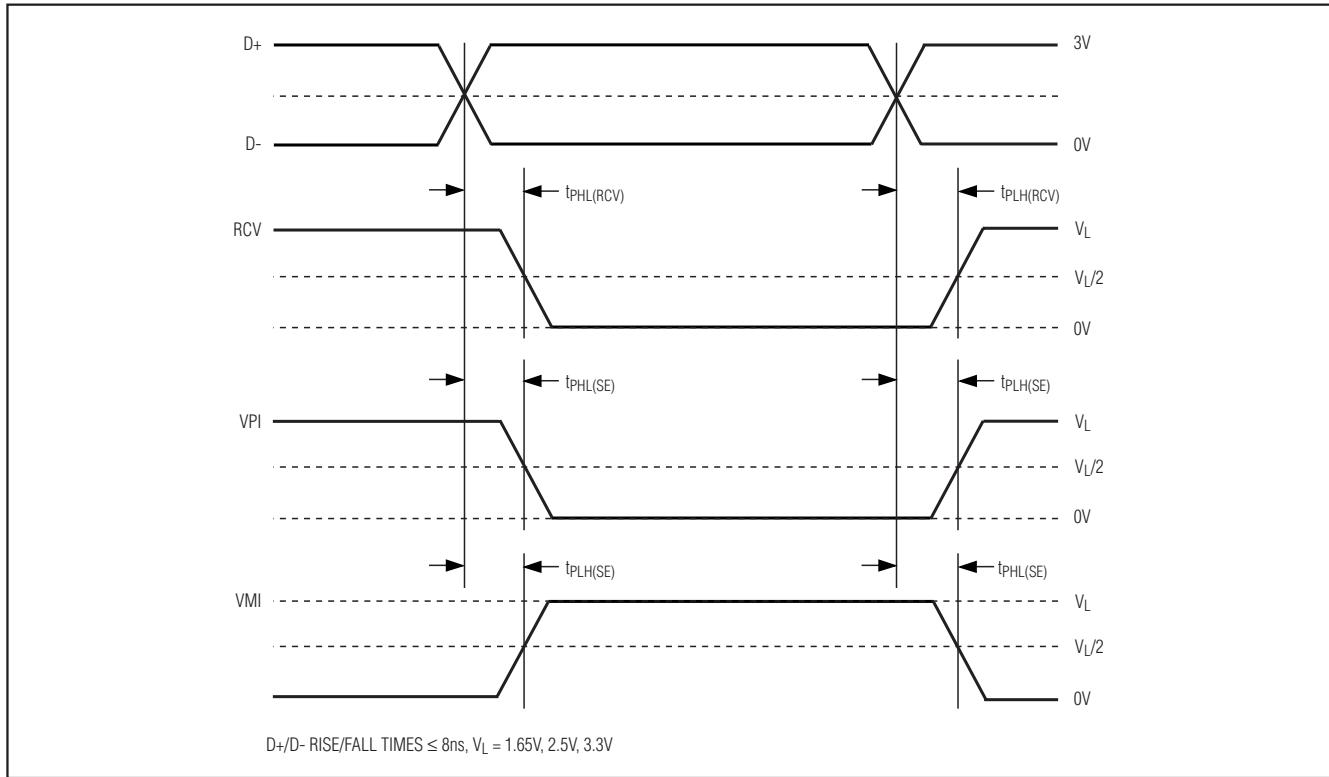


图5、D+/D- 至RCV、VPI、VMI的传输延时

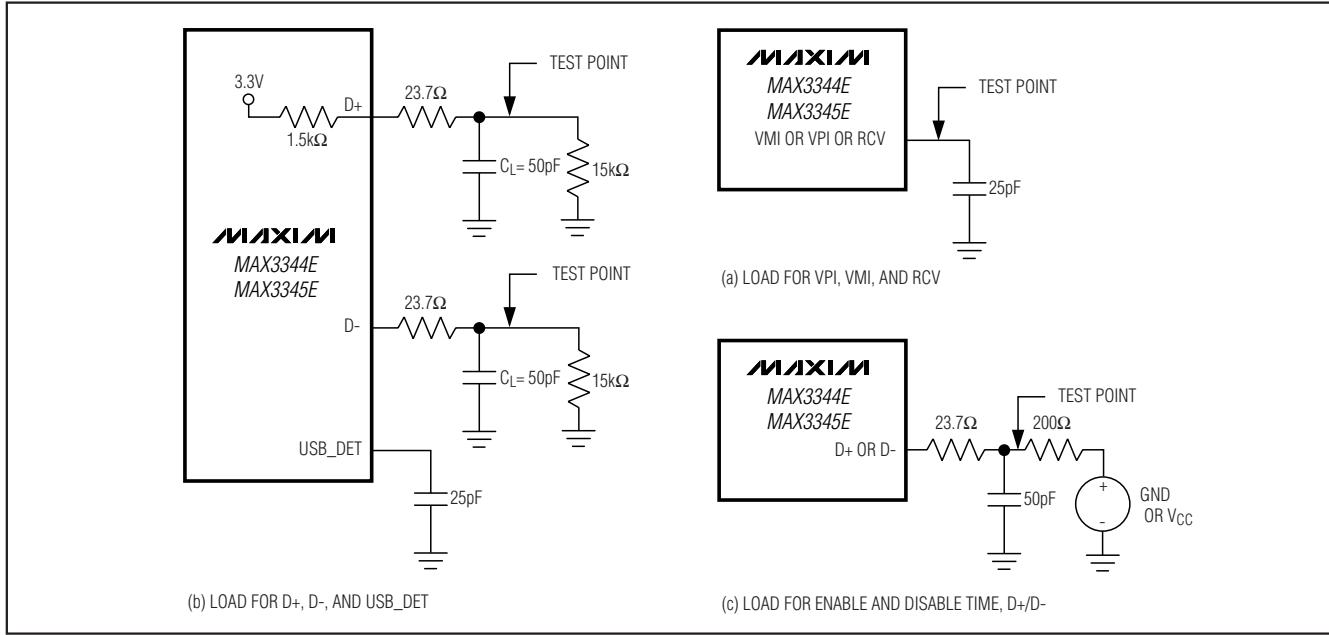
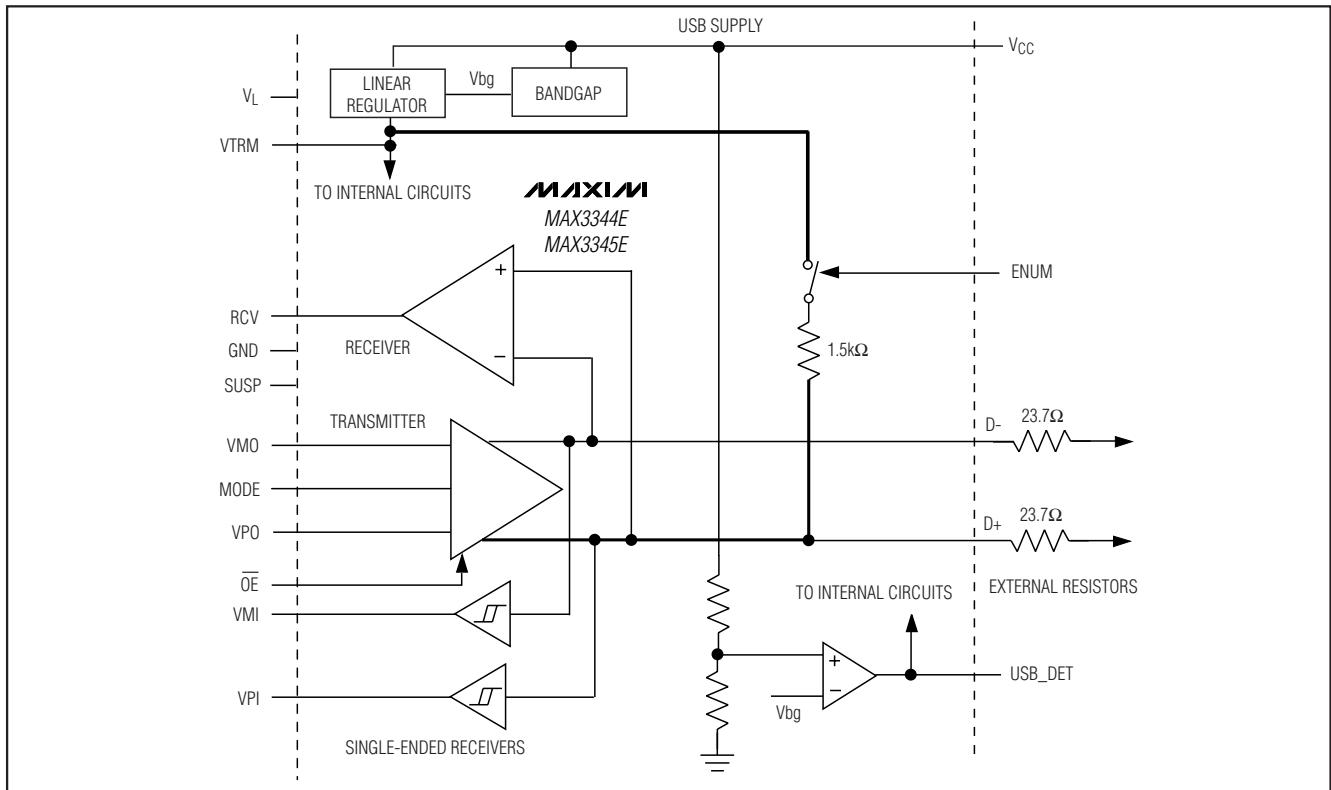


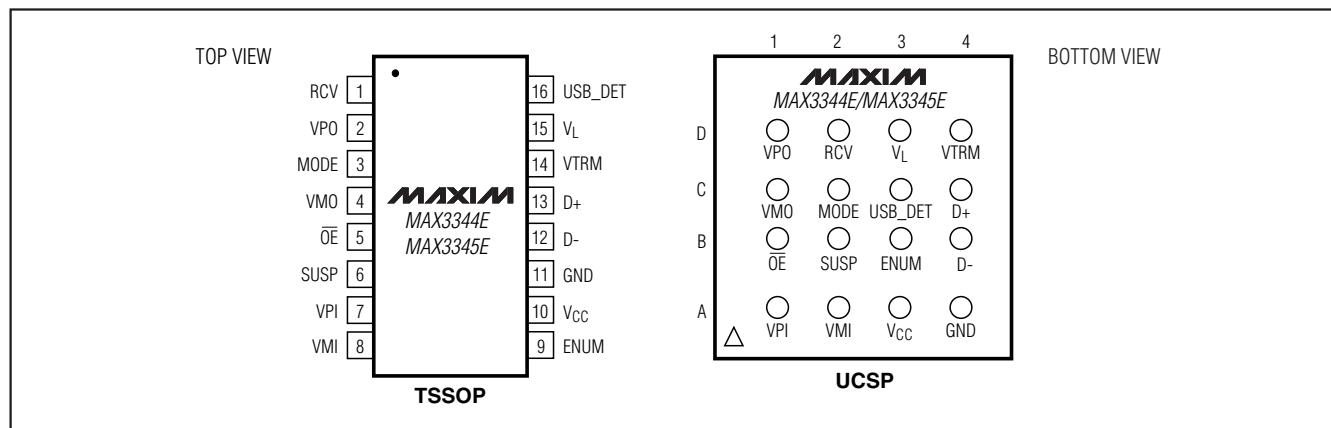
图6、测试电路

具有 $\pm 15kV ESD$ 保护的USB收发器，UCSP封装，带USB检测

功能框图

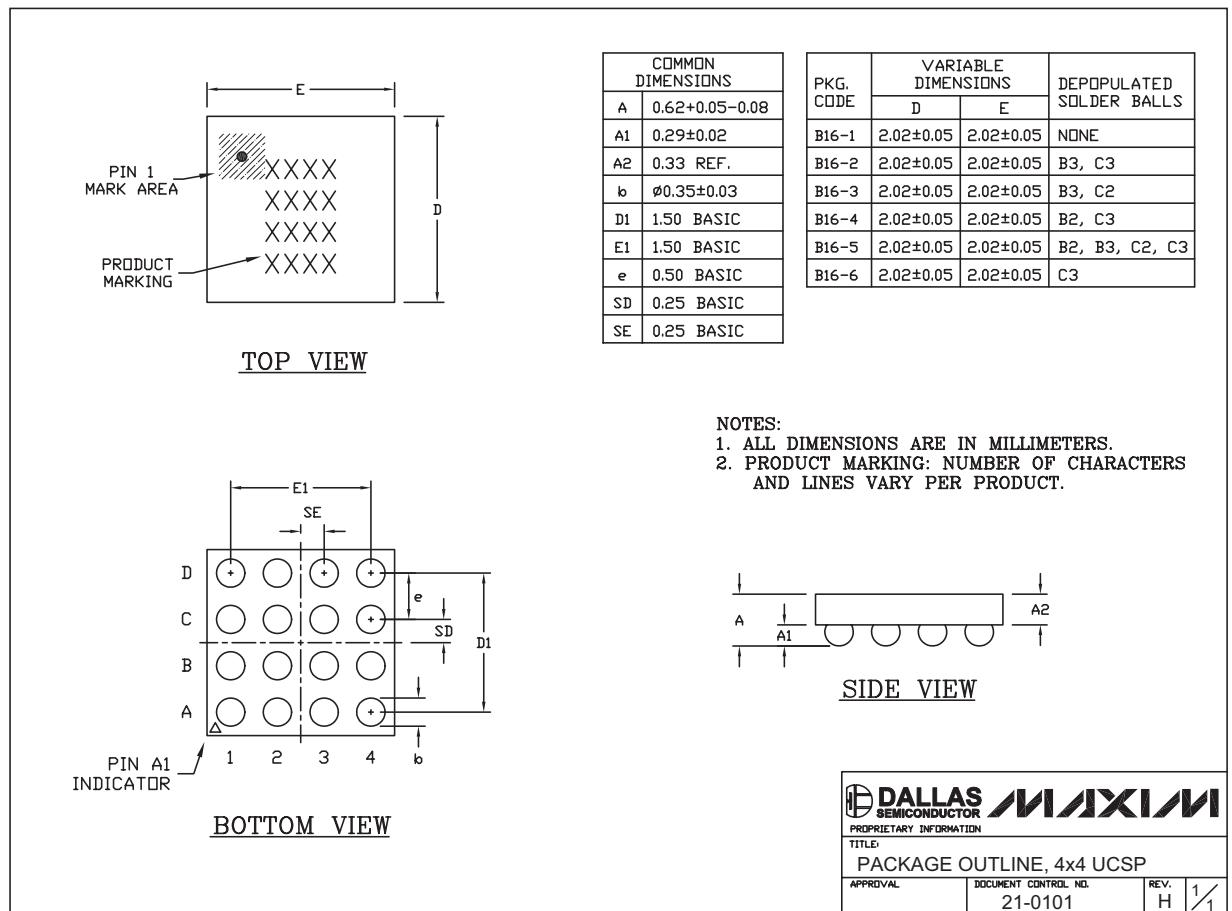


引脚配置



具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB收发器， UCSP封装，带USB检测

封装信息

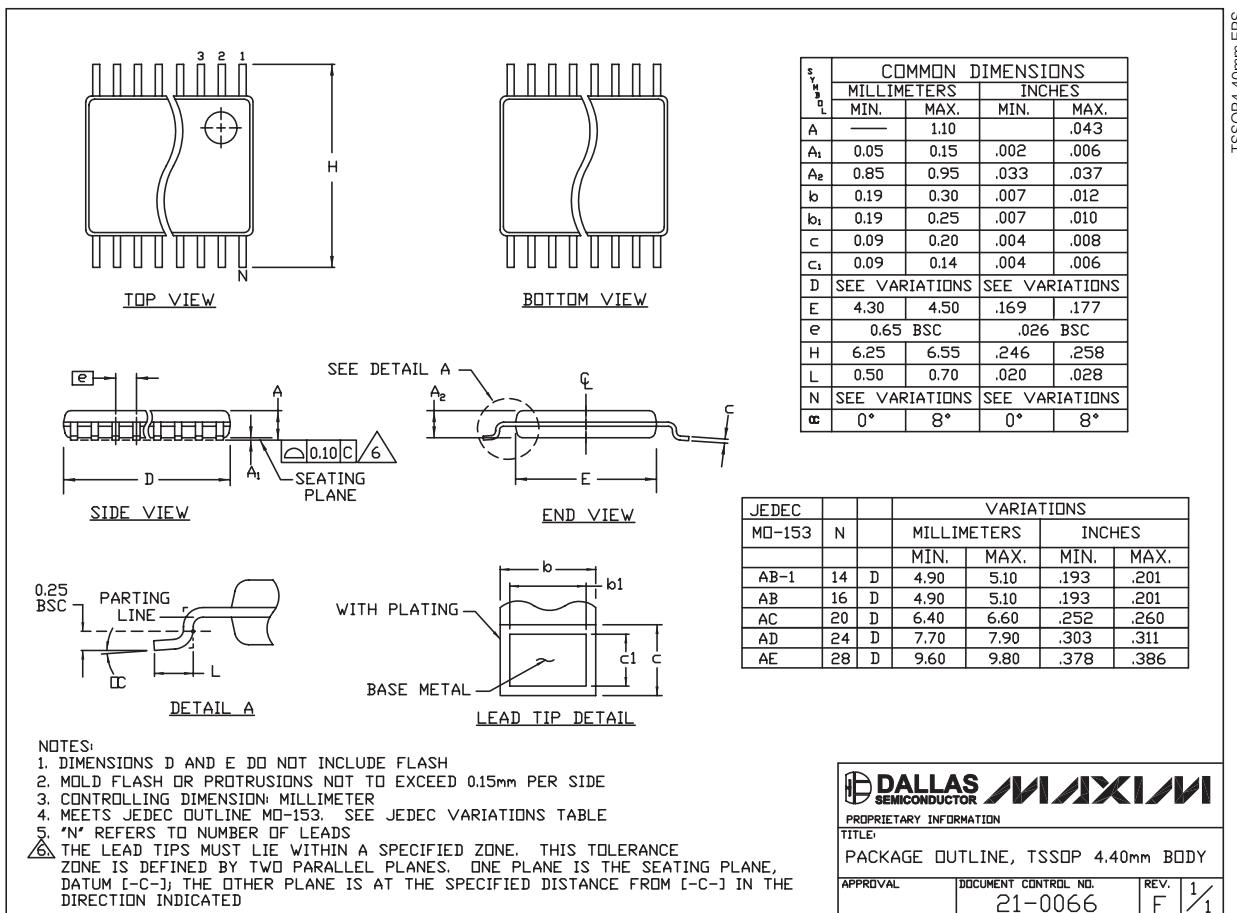
(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格，如需最近的封装外型信息，请查询www.maxim-ic.com/packages。)

16LUCSP.EPS

具有 $\pm 15kV$ ESD 保护的USB收发器, UCSP封装, 带USB检测

封装信息(续)

(本数据资料提供的封装图可能不是最近的规格, 如需最近的封装外型信息, 请查询 www.maxim-ic.com/packages.)



TSSOP4.40mm EPS

MAX3344E/MAX3345E

MAXIM北京办事处

北京 8328 信箱 邮政编码 100083

免费电话: 800 810 0310

电话: 010-6201 0598

传真: 010-6201 0298

Maxim 不对 Maxim 产品以外的任何电路使用负责, 也不提供其专利许可。Maxim 保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600

15